

11月26日アナリスト向け決算説明会質疑応答（2022年3月期第2四半期決算）

Q. 各事業の課題と今後の成長戦略について伺いたい。

A. 懸架ばね事業とシート事業が屋台骨であり、確実に収益を上げる事業とするのが基本的な考えである。

懸架ばね事業は、日本では可動率が高いが数量減により稼働率が低下しており、米欧他では数量減により稼働率が低下しているだけでなく可動率も低い状態となっている。特に米国の可動率を上げる努力をしながら、売価改善の交渉を続けていく。また、新しい形状のばねや新しい機能を持った製品開発も同時進行で行っていく。営業利益率の目標は目先6%とし、将来的には更に上を目指す。

シート事業は、国内では継続的な改善活動をベースに管理能力の向上、コスト削減を含めしっかり受注を継続できるよう進めていく。海外では適宜生産体制を見直し利益を確保していく。営業利益率の目標は目先3%とし、将来的には更に上を目指す。

精密部品事業は、モーターコアを2023年までに現在の売上高（約40~50億円）の3倍程度にすることを目標としている。モーターコアは、メキシコ、中国、日本とグローバルに拠点がある点が強みであり、それを活かして大きな事業にしていく。

産業機器ほか事業では、成長著しい半導体プロセス部品に加え、電動化が進むことにより益々高い放熱性と設計の自由度が求められる金属基板の市場が大きく伸びる見込みである。なお、金属基板のシェアは、30%を超え業界でトップシェアとなっている。自動車業界で培ってきた実力と高い信用度を活かして大きな事業に育てていく。

全体像としては、自動車関連部品で、安定的な収益基盤の強化を図り、新しい事業でしっかり稼げる体制にしていく。

Q. 半導体製造プロセス部品におけるニッパツの強みは何か。

A. 本製品に関する技術は特殊技術であり、他社では真似ができない。また、数ミクロン単位の精度の高い機械加工技術が必要となる。更に、製品の評価実験をお客様と同条件で出来る設備を保有している。このような一連の開発・設計・生産ができる点において、他社と比較し競争力が高いと考えている。

Q. 半導体プロセス部品のお客様の構成と納入シェアについて伺いたい。

A. お客様は、大手半導体製造装置メーカー各社であり、売上高の構成としては、それぞれのお客様の市場シェア比率と同様のイメージである。

納入シェアについては、各社3分の1程度である。

- Q. 半導体プロセス部品の競合先、利益率について教えてほしい。
- A. 競合先は、部分的な競合はあるものの、生産だけではなく、材料から製品の評価開発まで出来る競合先はない。利益率は、設備投資が大きいいため変動幅が大きくなる傾向があり、数%から数十%程度である。
- Q. 半導体プロセス部品は消耗品とのことだが、新規品と補修品の割合はどの程度か。
- A. 詳細は当社では不明であるが、恐らく半々程度ではないか。
- Q. 半導体プロセス部品の需要は非常に強いが、生産量は需要に追いついているのか。
- A. お客様からの増産ニーズは非常に高い状況が続いており、調整させていただきながら対応している。
- Q. 半導体プロセス部品は、2025年に売上高300億円を目指すとしているが、現在の状況を考慮すると売上高は300億円を優に超えるのではないか。
- A. 今後の半導体市場の動向を正確に見通すのは難しい面があるため、機会損失と過大投資を避けることを考慮し、まずは売上高300億円に対応できる設備を準備していく。
- Q. 半導体プロセス部品は、成膜装置、エッチング装置向けの成膜装置は特にALD（原子層堆積）ということだが、これは枚葉ALD装置か。
- A. CVD（化学気相蒸着）が多く、ALDは一部である。エッチング装置向けは全て枚葉タイプである。
- Q. モーターコア市場の状況について伺いたい。
- A. 電動化により市場は急速に拡大するものの、2035年頃まで内燃機関も使用されると見込まれる。また、車種により求められる特性や機能が異なるため、どのようなニーズが実需に繋がるかどうかを見極める必要がある。
- Q. 精密部品事業における、ハードディスクサスペンションと自動車部品の売上割合について伺いたい。
- A. ハードディスクサスペンションが約40%、自動車部品が約60%である。

以上